

The background of the slide features a complex, abstract pattern of overlapping triangles and squares in various shades of blue, ranging from light cyan to deep navy. The pattern is denser on the right side and fades towards the left.

# 株式会社テラプローブ 決算説明資料

2014年3月期

The background features a complex geometric pattern of overlapping triangles and squares in various shades of blue, from deep navy to light cyan. A faint grid is visible over the pattern. A horizontal bar with a light blue gradient and a fine dot pattern spans across the middle of the page.

# 2014年3月期業績説明

## FY2013業績の概要①

### メモリ事業

- 国内、台湾ともモバイル用メモリが年間を通して好調
- ゲーム用メモリの受託数量は前年度比増加
- 半導体ユーザー企業(セットメーカー)からの受託が順調に増加

### システムLSI事業

- テスト受託は国内、台湾とも前年度から順調に増加
- WLP・BUMP受託加工は数量が減少



**前年度比売上高は微増だが営業利益が改善**

## FY2013業績の概要②

### 特別利益の計上

- 2011年度、2012年度に広島事業所で実施した設備投資に対し、広島県、東広島市から助成金が交付されることが決定(475百万円)

### 特別損失の計上

- 青梅事業所を中心に固定資産の減損処理を実施(842百万円)
- 一部従業員の転籍予定に伴い早期退職費用の引当て(111百万円)



**営業利益は改善するも、当期純利益は減少**

# FY2013 (4Q) 実績

(億円)

		前年同期比較(通期)			前四半期比較		
		FY2012	FY2013	YoY増減	3Q/FY2013	4Q/FY2013	QoQ増減
売上高	メモリ	152.4	160.3	7.9	43.1	38.3	-4.8
	システムLSI	60.6	56.4	-4.2	12.7	13.7	1.0
	その他	-0.1	-0.1	0.0	0.5	0.2	-0.3
売上高		213.0	216.6	3.6	56.4	52.3	-4.1
営業利益	メモリ	18.6	29.0	10.4	11.9	8.6	-3.3
	システムLSI	-4.9	-8.1	-3.2	-3.6	-3.0	0.6
	その他	-14.1	-12.5	1.6	-3.3	-3.0	0.3
営業利益		-0.4	8.3	8.7	5.1	2.6	-2.5
営業利益率		-0.2%	3.8%	4.0%	9.0%	5.0%	-4.0%
当期純利益		5.0	0.6	-4.4	2.5	-2.2	-4.7
当期純利益率		2.3%	0.3%	-2.0%	4.4%	-4.2%	-8.6%

## FY2013業績 増減分析

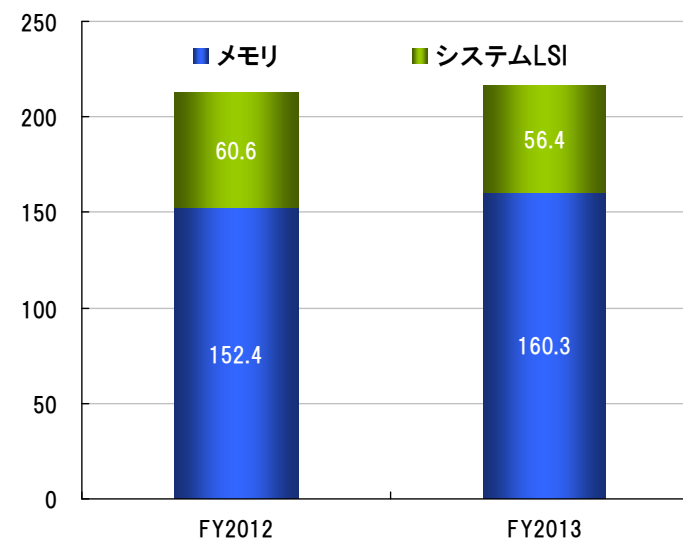
### FY2013売上高(YoY)

#### <メモリ事業>

- ・テスト時間の短縮は継続しているが、モバイル向け製品の増加に伴い、売上高が増加

#### <システムLSI事業>

- ・テスト受託は緩やかに増加したものの、WLP・BUMP受託減により、売上高が減少



単位: 億円

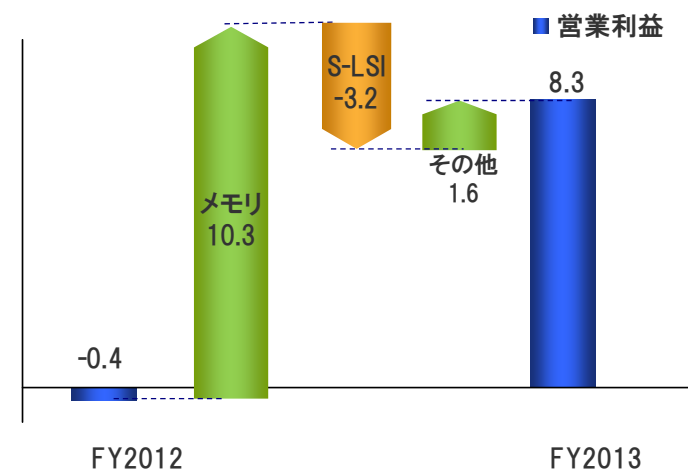
### FY2013営業利益(YoY)

#### <メモリ事業>

- ・売上高の増加により利益が改善

#### <システムLSI事業>

- ・テスト受託は緩やかに増加したものの、WLP・BUMP受託減により業績改善に至らず



単位: 億円

# 4Q/FY2013業績 増減分析

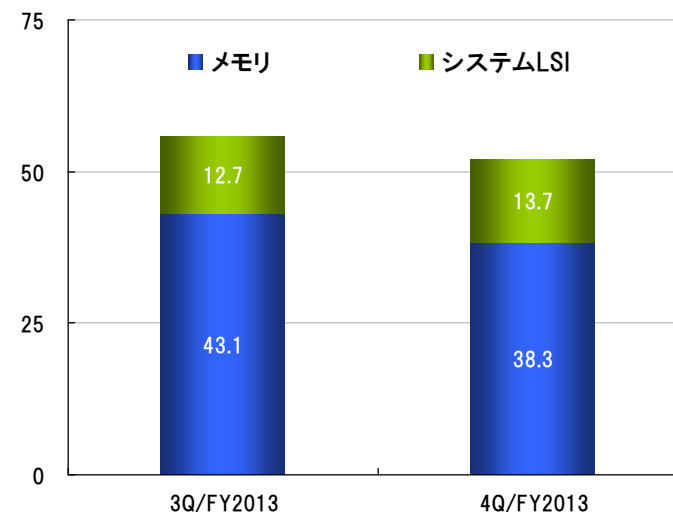
## 4Q/FY2013売上高(QoQ)

### <メモリ事業>

- ・モバイル向け受託数減少により売上高が減少

### <システムLSI事業>

- ・テスト受託、WLP・BUMP受託とも売上高が緩やかに改善



単位: 億円

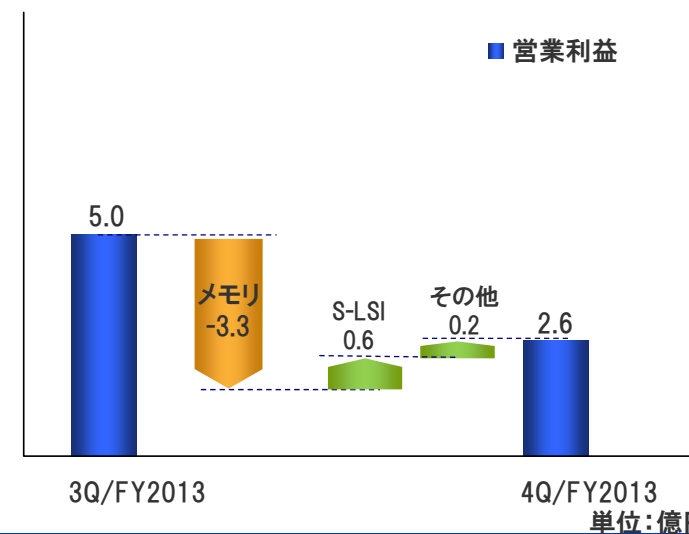
## 4Q/FY2013営業利益(QoQ)

### <メモリ事業>

- ・費用削減を進めるも、売上高の減少をカバーできず減益

### <システムLSI事業>

- ・テスト受託、WLP・BUMP受託とも売上高の増加により損益がやや改善



単位: 億円

## 貸借対照表の比較

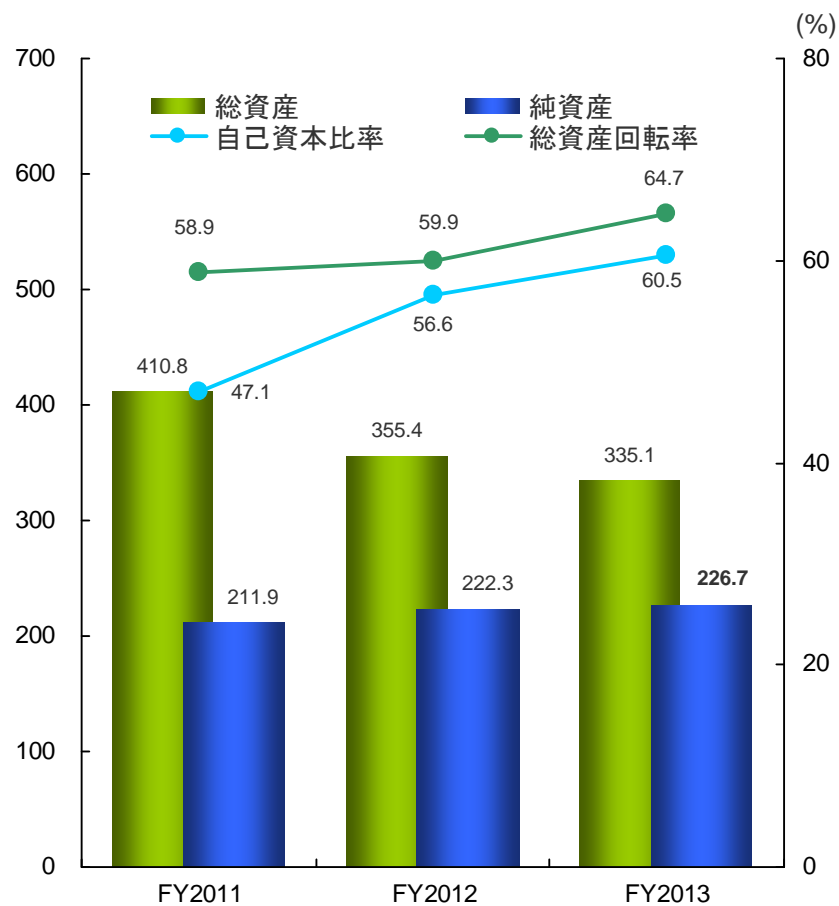
(億円)

	FY2012	FY2013	差異
<b>流動資産</b>	110.2	138.2	28.0
現金及び預金 等	62.4	86.7	24.3
売掛金	36.3	37.0	0.7
<b>固定資産</b>	245.1	196.9	-48.2
機械装置	169.8	128.9	-40.9
<b>資産合計</b>	355.4	335.1	-20.3
<b>流動負債</b>	77.6	76.8	-0.8
借入金	17.6	18.9	1.3
リース債務	27.2	25.3	-1.9
<b>固定負債</b>	55.4	31.5	-23.9
長期リース債務	45.2	21.9	-23.3
<b>純資産</b>	222.3	226.7	4.4
<b>負債純資産合計</b>	355.4	335.1	-20.3
<b>自己資本比率</b>	56.6%	60.5%	3.9%



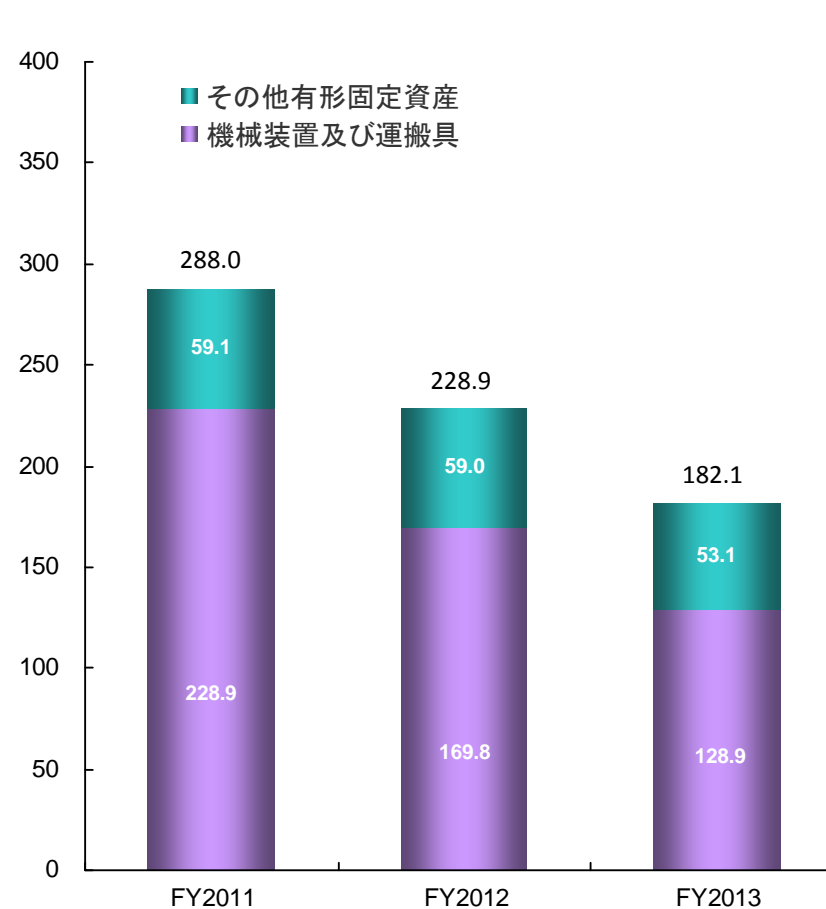
# 財務状況の推移①

## 総資産・純資産・自己資本比率



単位:億円

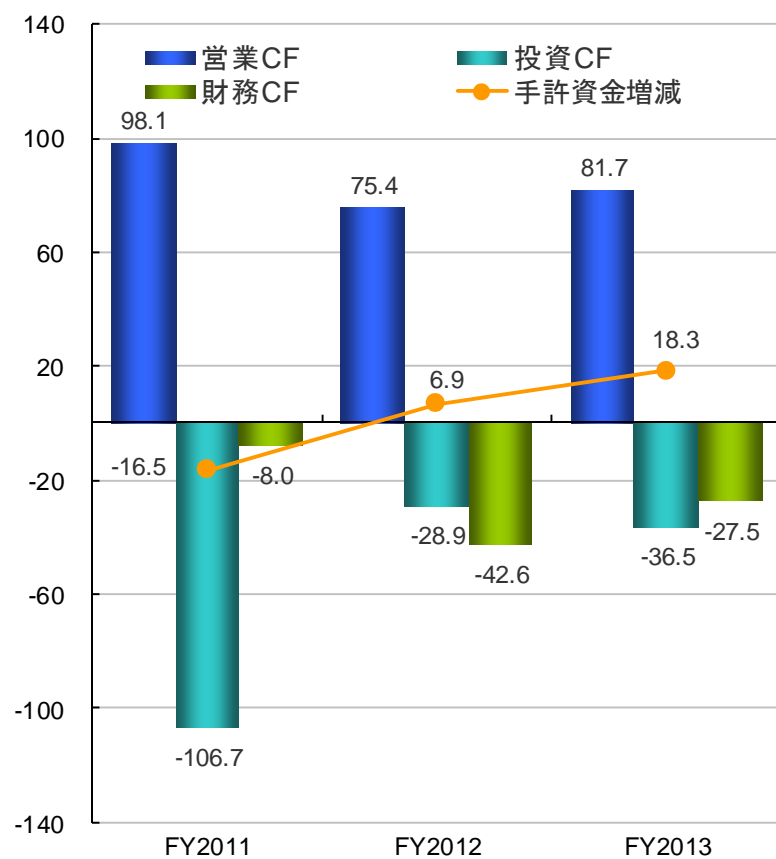
## 有形固定資産の推移



単位:億円

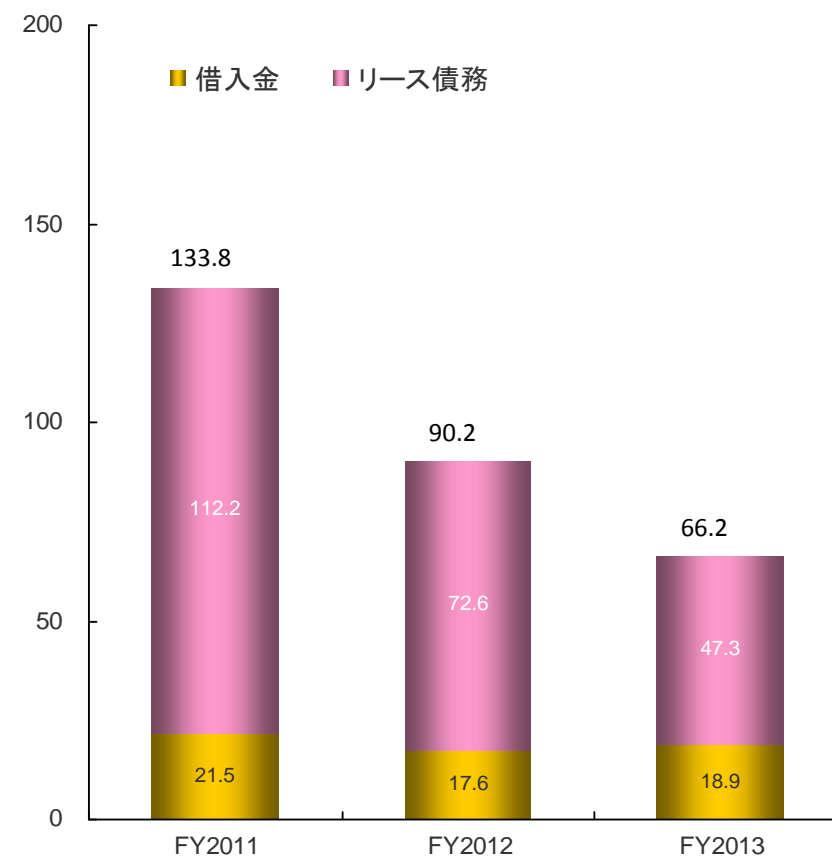
## 財務状況の推移②

### キャッシュフロー



単位:億円

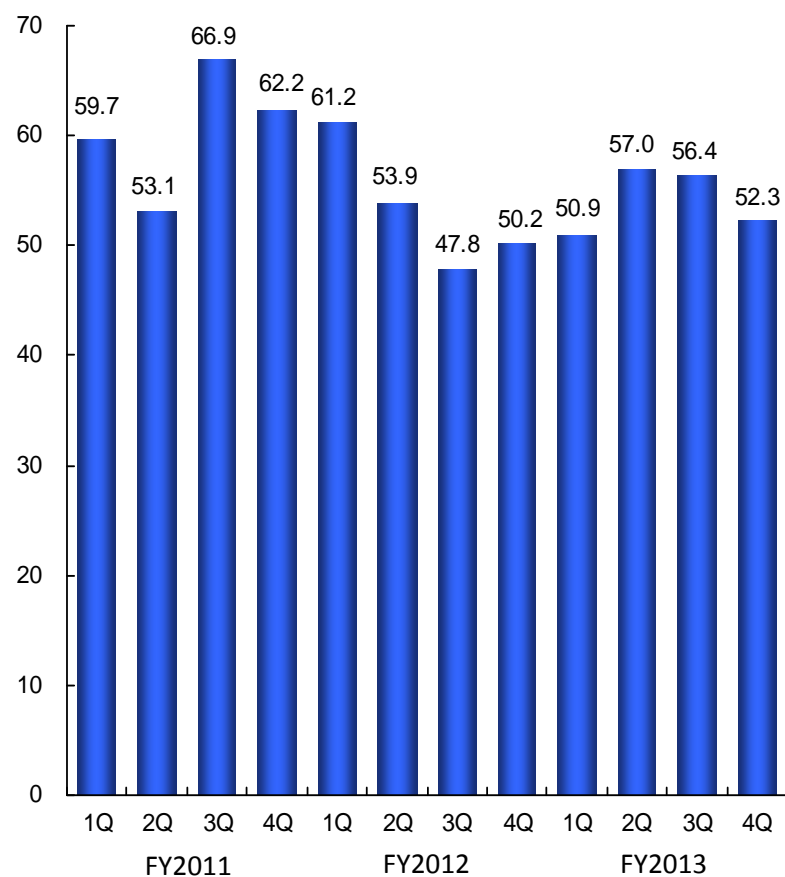
### 有利子負債残高



単位:億円

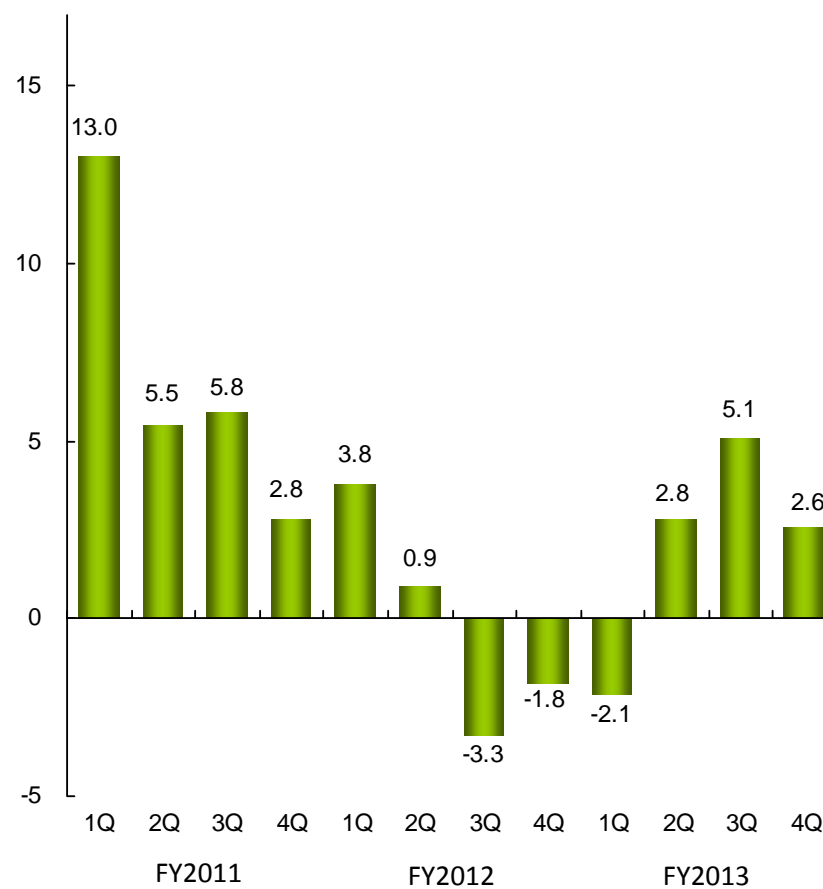
# 売上高及び営業利益推移

## 売上高推移



単位: 億円

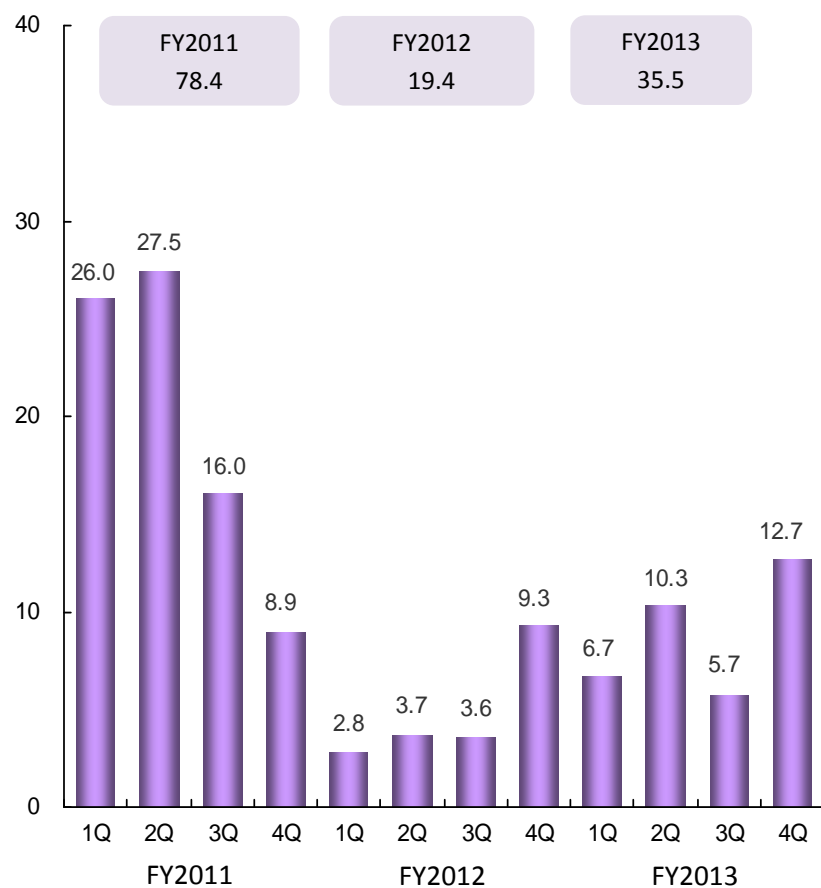
## 営業利益推移



単位: 億円

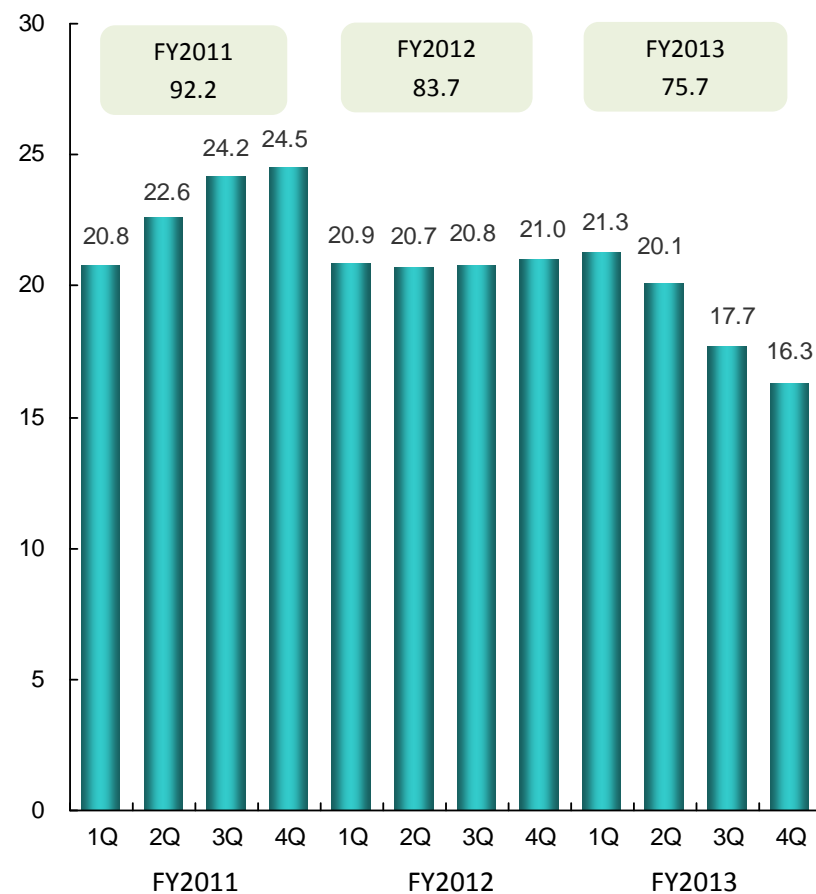
# 設備投資及び減価償却

## 設備投資額推移



単位:億円

## 減価償却費推移



単位:億円

## 4Q/FY2013 トピックス

### 先行技術開発室の設置

#### ●画像処理技術を応用したソフトウェア開発

NEC製顔検出／顔照合エンジン「NeoFace®」※のアルゴリズムを採用し、ARM® Core※等に対応した製品開発を行う

#### ●生体信号(脳波、心電等)を用いたヒューマンインターフェース技術の研究

ハンズフリーでのウェアラブル機器の操作や医療、福祉用途の身体情報収集など



**第17回組込みシステム開発技術展に出展**  
(東京ビッグサイトにて5/14-16開催)

※「NeoFace」は、日本電気株式会社の登録商標です。  
ARM はARM Limited の登録商標または商標です。

### Supplier Quality Awardの受賞

#### ●顧客満足の追求

ON Semiconductor社のAnnual Perfect Quality Award2013を受賞しました

年間を通し、規定取引量以上を維持し、品質トラブルが無く、品質評価項目が満点により、Foundryカテゴリでは、当社1社の受賞となりました

# 2015年3月期第1四半期業績予想

# 1Q/FY2014業績見込み

(億円)

	1Q/FY2013	4Q/FY2013	1Q/FY2014	QoQ増減	YoY増減
売上高	50.9	52.3	50.0	-2.3	-0.9
営業利益	-2.0	2.6	0.5	-2.1	2.5
営業利益率	-3.9%	5.0%	1.0%	—	—
経常利益	-2.5	2.2	0.2	-2.0	2.7
当期純利益	-2.0	-2.2	-1.0	1.2	1.0
当期純利益率	-3.9%	-4.2%	-2.0%	—	—

ハイエンド品を中心にモバイル機器市場に停滞感があり、前四半期比ではメモリ事業、システムLSI事業とも売上高減少見込み

当社グループが属する半導体業界は市場環境が短期間に変化するという特徴があり、1年間の業績予想を作成することが困難であることから、連結業績予想は翌四半期のみを開示することといたします。

## FY2014の取り組み

### メモリ事業

- 次世代DRAM(20nm・積層・不揮発)への対応
- 高速測定技術
- 車載用DRAM
- カスタムメモリ

### システムLSI事業

- テスト受託
    - 車載向け製品
    - イメージセンサ製品
    - 国内メーカーの海外展開
  - WLP・Bump受託
    - Cu Post-Type以外にもU-Type、Bump事業等幅広いラインアップ
    - WLP for DRAM、ウエハレベルカメラ開発強化
    - 固定費圧縮による収益性向上
- ⇒ TS16949認証(予定)  
モバイル、医療関係  
台湾(TeraPower)での国内メーカー取り込み



## 本資料における注意事項等

- 本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社テラプローブ(以下、弊社)の現状を理解していただくために作成したものです。
- 本資料に記載された内容は、2014年5月9日時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
- 投資を行う際は、必ず弊社が作成する「平成26年3月期決算短信」をご覧ください。また、投資家ご自身の判断において行っていただきますよう、お願い致します。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社テラプローブ  
コーポレートプランニング・IR部門  
TEL (045)476-5711  
URL <http://www.teraprobe.com>